

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Le bus de rail profilé complet pour le système modulaire de boîtier électronique**

Pour l'alimentation, la connexion et la répartition dans les applications modulaires, le bus de rail profilé remplace le câblage individuel coûteux par une solution système sans interruptions et flexible.

Le bus système est intégré de façon sûre dans le rail profilé standard de 35 mm. Le bloc de contact de bus SMD peut être traité d'une manière totalement automatique lors de la production de sous-ensembles par un procédé de refusion. Les surfaces de contact résistantes et dorées garantissent un contact durable et fiable pour toutes les largeurs de boîtiers.

- **Échelonnement sans limites** - la solution de connexion complète pour toutes les largeurs de systèmes – de la plaque de 6 mm au boîtier grande capacité de 67 mm.
- **Installation facile à réaliser** – remplacement de modules facile même dans les groupes de modules et sans effet sur les modules voisins.
- **Intégration universelle** - bus système sans interruptions : intégré en toute sécurité sur le rail profilé de 35 mm standard.
- **Disponibilité maximale** – Cinq contacts doubles coulés totalement galvanisés et partiellement dorés garantissent un contact durable avec le bus du rail profilé. Les brides soudées THR garantissent une connexion stable au circuit imprimé.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M6, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
Référence	1155850000
Type	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
GTIN (EAN)	4032248942374
Qté.	300 pièce(s)
Indices de produit	IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
Emballage	Tape

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	5,9 mm	Hauteur (pouces)	0,232 inch
Largeur	16,3 mm	Largeur (pouces)	0,642 inch
Longueur	24 mm	Longueur (pouces)	0,945 inch
Poids net	1,6 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-18-27-92


Données des matériaux

Matériau isolant	LCP	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	175 ≤ CTI <400	Tenue d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Surface du contact	doré
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	70 °C
Température de fonctionnement, min.	-50 °C	Température de fonctionnement, max.	100 °C
Plage de température montage, min.	-30 °C	Plage de température montage, max.	100 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	3,6 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	160 V	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	100 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	63 V	Tenue aux courants de faible durée	3 x 1s with 14.5 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/3	1,5 kV	Espace libre, min.	2,3 mm
Ligne de fuite, min.	3,2 mm		

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)		Certificat N° (cURus)	E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)	50 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)	50 V	Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)	5 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059)	5 A	Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)	5 A
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.		

Caractéristiques des matériaux

Groupe de matériaux isolants	IIIa	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	175 ≤ CTI <400
Matériau isolant	LCP		

Date de création 18 mai 2024 11:31:22 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Couleur	noir	Degré de protection	IP20
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011		

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
----------------	--

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E60693

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

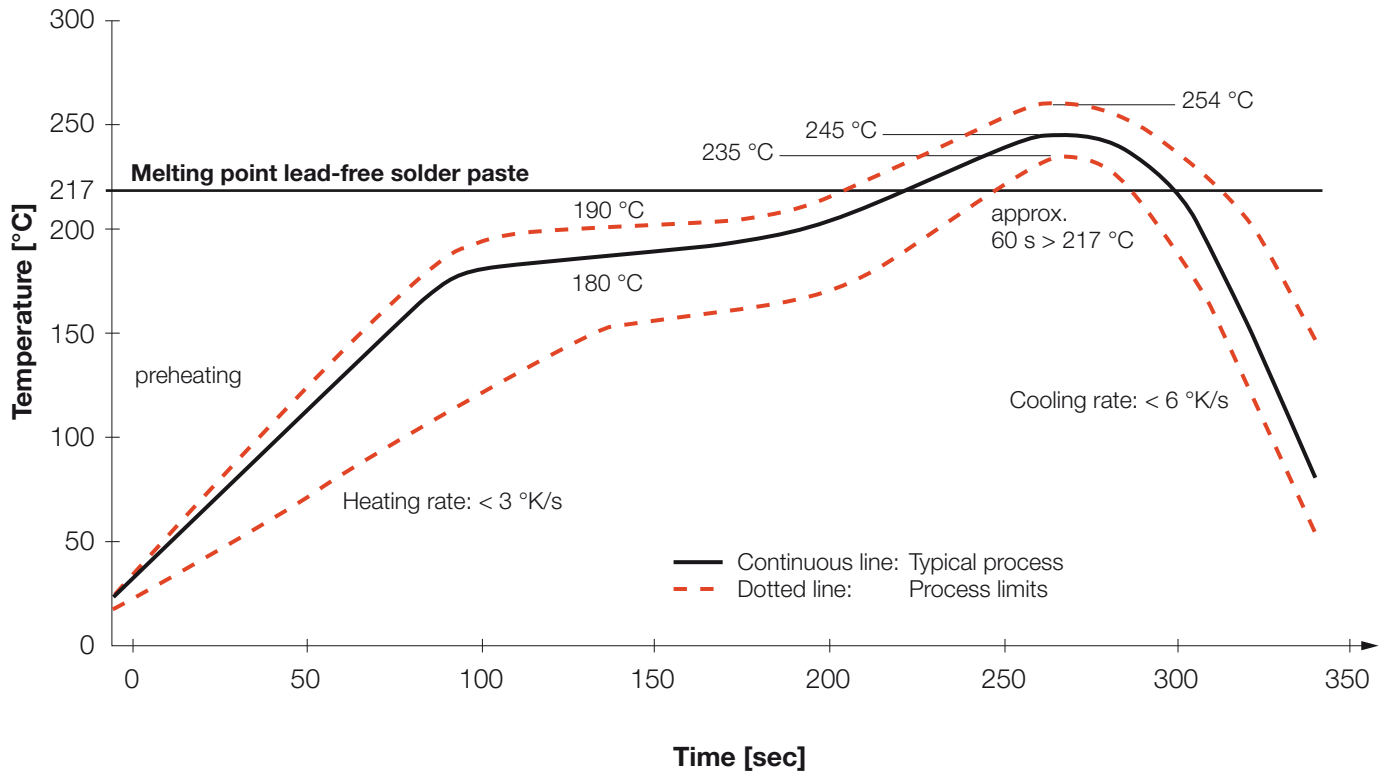
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.